

NC275LR 免洗液态助焊剂

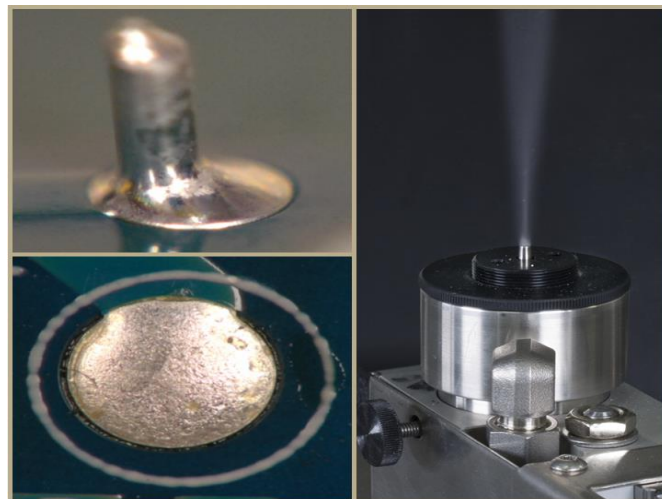
特性

- ▶ 按 ASTM D3960-98 标准为 VOC-Free
- ▶ 已通过 IPC J-STD-004B 标准
- ▶ 工艺窗口宽广
- ▶ 能耐受更长的停留时间
- ▶ 快速润湿
- ▶ 符合 REACH/RoHS 要求
- ▶ 低残留

描述

NC275LR 是一款水基无卤免清洗液态助焊剂。工艺窗口宽广，润湿性极佳，即使在难以润湿的和 OSP 表面。NC275LR 活性持久，可用于多种工艺参数和应用，包括与锡-银-铜，锡-银，锡-铜和其它无铅合金的焊接。NC275LR 低味，低烟且能迅速蒸发。NC275LR 在托盘波峰焊和点至点选择性焊接上也是非常安全的。工艺完成后，NC275LR 残留物可以留在电路板上，去除残留物不是必需的。

特点



处理及储存

参数	时间	温度
密封条件下	9 个月	室温

密封的 NC275LR 可在室温下储存 9 个月。避免光照，它可能会降低产品质量。NC275LR 可直接使用无需搅拌。请勿将使用过的和未使用的产品混合装同一容器内。请重新密封已开的容器。储存条件范围为 4-40° C (40-100° F)。

应用

NC275LR 有喷雾和薄雾等方式以适应不同的应用。不推荐泡沫。NC275LR 可以从容器中取出直接使用。当喷洒助焊剂时，必须使用适当的量均匀覆盖。起始时建议每平方英寸涂抹 500-1500 微克。氮气的使用不是必需的，但也可以。

工艺指导

使用热电偶焊附于PCB板上表面, 表面装配温度应在100-135° C (212-275° F)。保证助焊剂在触波前干燥以防止助焊剂飞溅。可能会有烟, 但是只要不是大量烟雾就是正常的。推荐接触的时间取决于波峰的配置, 锅内温度, 合金类型和4-7秒装配热质量。如需协助, 请联系 AIM 技术支持 <http://www.aimsolder.com/technical-support-contacts>。


清洁

NC275LR 可用皂化剂或化学清洁剂进行清洁。联系 AIM 以获得更多信息。建议用去离子水做最后清洁。

安全

保持通风并使用适当的个人防护装备。对于任何特定的紧急情况, 请参照 SDS 信息。不要在未核准的容器内处理任何有害物质。

测试数据小结

名称	测试方法	结果	图像
IPC 助焊剂分类	J-STD-004	ORLO	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004B 3.3.1	ORLO	
名称	测试方法	结果	图像
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	溴 0.00% 氯: 0.00%	
定量卤化物, 铬酸银	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	

名称	测试方法	结果	图像
定量卤化物, 氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟	
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	通过	
助焊剂固体含量、 非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	3.16% 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	25.5 mg KOH per gram flux 典型值	
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	1.00 典型值	
pH 值 (1%溶液 /水)	ASTM D5464 ASTM G51	2.71 典型值	
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	通过	